

## 2024 高导热材料与应用技术交流大会

在消费电子和 5G 通信等领域，随着电子信息技术的快速发展，内部器件向小型化、高频化和功率化方向不断升级，使用过程中不可避免地由于热量聚集造成过热升温，高温会严重降低电子器件的寿命、性能及其可靠性，从而引起整个电子产品的故障。目前普遍认为，开发高导热材料是解决以上问题的关键。

在新能源汽车以及储能领域，随着电池的能量密度越来越高，对散热的要求也越来越高。高温会对电池的性能和可靠性带来不利影响，甚至会引发安全性问题。

在人工智能领域，ChatGPT 技术的推广将进一步催生 AI 算力等大规模应用场景的普及，大型算力中心将对服务器机柜、电池柜、传输等设施设备提出更广阔、更严格的散热需求。由此可见，高导热材料将在众多新兴领域和未来市场有着非常乐观的发展前景。

目前正在飞速发展的新兴领域正带来哪些导热材料需求？未来又有哪些潜在市场？这些新兴领域和未来市场对导热材料会提出哪些要求？高端导热材料国产化程度如何？这些问题受到行业人士广泛关注

在此背景下，中国粉体网将于 2024 年 5 月 30 日在南京举办 2024 高导热材料与应用技术交流大会，大会旨在为导热材料领域搭建技术交流、信息互通的沟通平台，促进导热材料行业技术与产业发展突破。

大会热诚欢迎国内外相关领域的专家、学者、科研人员、企业界代表积极参与，同时欢迎公司、企事业单位展示技术成果，洽谈产、学、研合作。

**主办单位：**



**时间：2024年5月30日（29日全天报到）**

**地点：江苏·南京**

**大会主题：**

- 1、高导热材料热点应用行业分析：新能源、半导体、人工智能等
- 2、陶瓷粉体材料及制品的应用
- 3、碳材料、金属粉体、高分子材料等在导热领域的应用
- 4、高端导热材料的国产替代现状
- 5、新型导热材料讨论

**特色活动：**

大会征集参会企业相关技术合作、产品采购、工艺方案等需求进行现场采配活动，相关信息将进行展板展示，提高现场沟通交流效率！

征集内容包含但不限于以下几点：

- 1、行业投资、融资需求
- 2、科研成果转化
- 3、产品工艺问题解决方案
- 4、原料、设备、仪器采购需求

**会议费用：**

2800元/人，包含：会议资料、入场证、午餐、晚宴等

**收款账户：**

户名	山东中粉会展服务有限公司
----	--------------

开户行	中国银行股份有限公司临沂北城支行
帐号	233841636876

**会务组：**

联系人：刘经理

联系方式：13693335961（同微信）

